日本学術振興会 結晶加工と評価技術第 145 委員会 委員長 田島 道夫

(独)日本学術振興会「結晶加工と評価技術」第 145 委員会 第127回研究会 開催通知

日時:2011年8月19日(金) 13:00~ 17:35

会場: 明治大学 駿河台キャンパス アカデミーコモン2階 A1会議室 http://www.meiji.ac.jp/koho/campus_guide/suruga/access.html

p://www.merji.ac.jp/kono/campus_guide/suruga/access.ntml 東京都千代田区神田駿河台 1-1(TEL 03-3296-4545)

JR 中央線・総武線、東京メトロ丸ノ内線/御茶ノ水駅 下車徒歩3分

東京メトロ千代田線/新御茶ノ水駅 下車徒歩5分

都営地下鉄三田線・新宿線、東京メトロ半蔵門線/神保町駅 下車徒歩5分

テーマ 「加工技術(研磨・洗浄・CMP 技術)の現状と将来」 - 次世代加工技術を求めて-世話人: 土肥俊郎(九州大学)、 末岡浩治(岡山県立大学)

原田博文((独)物質・材料研究機構)

プログラム (総合司会:末岡浩治)

13:00~13:05 開会の挨拶

田島道夫 柿本浩一

13:05~13:10 はじめに

十肥俊郎

13:10~13:50「Si, サファイア、SiC, GaNの研磨とメカニズム」

(株フジミインコーポレーテッド・玉井一誠

13:50~14:30「セリアと酸化マンガンスラリーによるガラス研磨」

九州大学・山崎 努

14:30~15:10「先端洗浄技術の現状と今後」

次世代半導体材料技術研究組合(CASMAT)·伊藤篤史

15:10~15:30 休憩

15:30~16:10「ポリシングパッドの表面性状の測定・評価技術」

金沢工業大学/九州大学:畝田道雄

16:10~16:50「3 次元実装のための高速・精密シリコン基板の薄片化ウエットエッチング技術」

(株)プレテックAT・吉川和博

16:50~17:30「深紫外線レーザーを用いた欠陥検査技術」

(アプライドマテリアルズジャパン株式会社・水野晋介)

17:30~17:35 おわりに 原田博文

17:40~19:40 懇親会(場所: リバティータワー23 階 サロン燦)